

# 114 年我國出進口貿易概況

財政部統計處  
殷英洳科長  
張麗娟研究員  
115 年 2 月 23 日

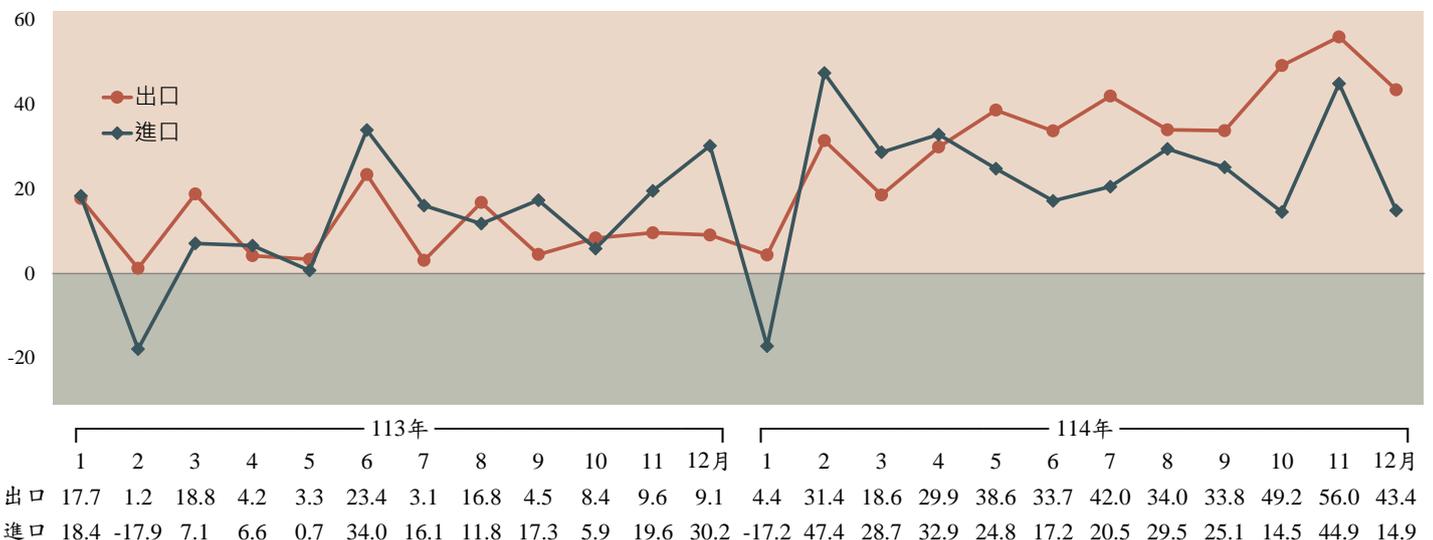
## 一、前言

去(2025)年全球經濟在美國實施對等關稅及相關貿易政策不確定性環伺下，仍展現相當韌性，除因此引發的提前拉貨潮外，人工智慧(AI)應用面加速擴展，帶動算力需求與相關投資升溫，更進一步活化全球供應鏈運作，為跨境貿易注入新能量。我國憑藉半導體及資通訊產業之競爭優勢，居於全球關鍵製造與系統整合節點，適時掌握此波新興科技應用商機，使全年出、進口分別成長 34.9%、22.6%，出口規模並首度跨越 6 千億美元大關，以下摘要分析其變動趨勢及內涵。

## 二、114 年出口成長 34.9%、進口亦增 22.6%

隨 AI、高效能運算及雲端服務等商機蓬勃發展，帶動相關科技產品需求不斷湧現，與下半年消費性電子新品備貨、外銷旺季效應加乘作用，我國 114 年出口呈逐月擴增，規模值先於 5~9 月站上 500 億美元，之後更連續 3 個月突破 600 億美元水準，年增率不僅延續 113 年以來之走升態勢，寫下連續 26 個月正成長，增速亦明顯加快，由 114 年 1~3 月平均

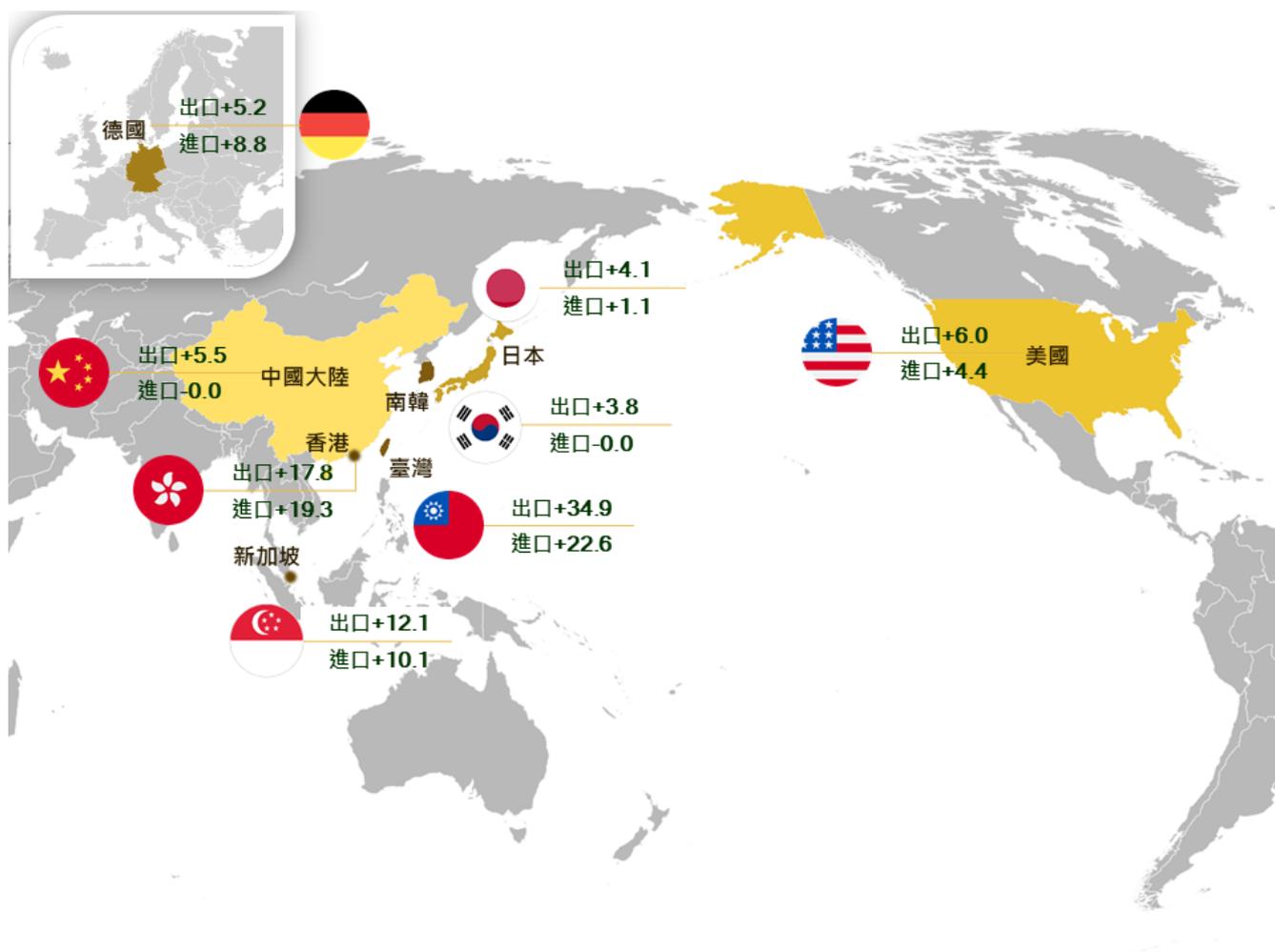
圖 1 近 2 年出進口年增率(%)



增 17.5%，至 10~12 月攀升為 49.4%。受惠於 AI 產業鏈之國際分工運作模式與出口引申需求上升，加以廠商積極購置資本設備，114 年各月進口均雙位數成長(不含農曆春節月份)，惟增幅大多低於出口成長率。綜計全年出口 6,407 億美元，自 4 千億美元一舉躍升至 6 千億美元，較 113 年成長 34.9%，為 15 年來最大增速，進口 4,836 億美元，同創歷年新高，年增 22.6%。

2025 年各國外貿景氣普遍回升，若與主要國家/地區比較，我國出口成長幅度相對顯著，優於香港 17.8%、新加坡 12.1%、美國 6.0%、中國大陸 5.5%、德國 5.2%、日本 4.1%、南韓 3.8%。進口方面，我國增幅亦高於主要經濟體，其中香港、新加坡分別成長 19.3%、10.1%，德國、美國各增 8.8%、4.4%，日本小增 1.1%，中國大陸、南韓與上年大致持平。

圖 2 2025 年主要國家/地區出進口年增率(%)



### 三、出口主要貨品

114年11類出口主要貨品與上年比較，其中資通與視聽產品、電子零組件、電機產品、光學及精密儀器出口增幅均呈兩位數增長，機械表現亦佳，其餘6貨類則呈衰退，除紡織品外，基本金屬及其製品、化學品、塑橡膠及其製品、礦產品及運輸工具等貨類均已連續3至4年下滑。

表1 114年主要貨品出口概況

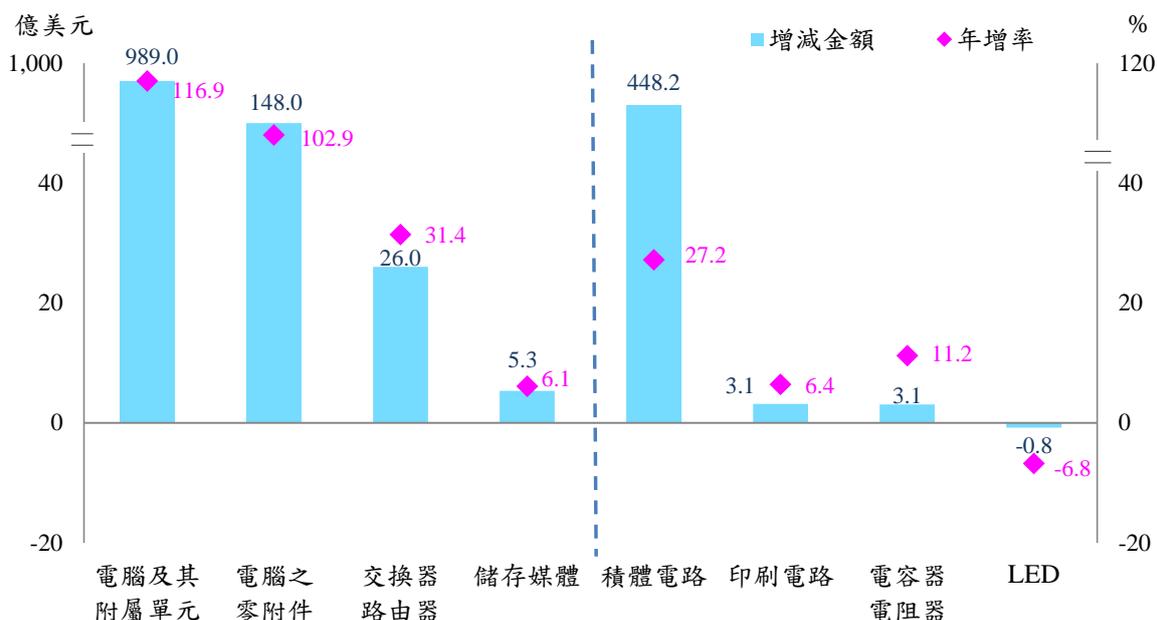
單位：億美元；%

出口主要貨品	合計	資通與 視聽產品	電子 零組件	基本金屬 及其製品	機 械	化學品
金額	6,407	2,512	2,229	279	258	183
占比	100.0	39.2	34.8	4.4	4.0	2.8
年增率	34.9	89.5	25.8	-2.0	7.0	-0.2
上半年	25.9	63.0	22.2	2.2	4.5	-0.4
下半年	43.0	113.2	28.7	-6.1	9.4	0.1
出口主要貨品	塑橡膠 及其製品	電機產品	礦產品	光學及 精密儀器	運輸工具	紡織品
金額	180	151	139	124	104	62
占比	2.8	2.4	2.2	1.9	1.6	1.0
年增率	-8.1	13.4	-0.2	10.2	-4.4	-7.5
上半年	-6.0	12.2	-1.2	10.9	-2.4	-5.9
下半年	-10.2	14.5	1.0	9.6	-6.3	-9.1

#### (一)AI 應用熱度延燒，資通產品全年外銷首破 2 千億美元

人工智慧技術與多元應用蓬勃開展，加之雲端服務供應商(CSP)擴大相關基礎建設投資，致使我資通與視聽產品外銷迭創佳績，114年出口達2,512億美元新高，躍居我最大出口貨類，年增1,187億美元(+89.5%)，對總出口增幅(+34.9%)貢獻25個百分點；其中電腦及其附屬單元增989億美元(+1.2倍)，項下主要增加產品為顯示卡、伺服器，電腦之零附件增148億美元(+1.0倍)，交換器及路由器增26億美元(+31.4%)，儲存媒體因SSD、隨身碟等產品出貨價量齊揚，增5.3億美元(+6.1%)。

圖 3 114 年各類資通產品及電子零組件出口變動情形



## (二)先進製程晶片供不應求，推升電子零組件出口創歷年新高

受惠於 AI 引領之創新科技應用持續湧現，加速電子及資通產品升級步伐，114 年電子零組件出口 2,229 億美元，創歷年新高，年增 457 億美元(+25.8%)；其中積體電路出口年增 448 億美元(+27.2%)，反映 AI 與高效能運算(HPC)對先進製程晶片需求之殷切；印刷電路、電容器及電阻器同因新興科技應用擴大，以及資料中心與電動車持續推升高階產品需求，加上消費性電子產品回溫，出口各增 3.1 億美元；發光二極體(LED)產業雖投入 Micro LED 研發與製造，並積極轉向高毛利領域發展，惟成效仍未全面彰顯，加以傳統應用仍面臨中國大陸競爭，LED 外銷已連續 4 年衰退。

由於電子零組件、資通產品之產銷因人工智慧全球產業鏈重組、部分廠商擴大在臺生產等出現結構性轉變，若將兩貨類併計，全年出口 4,740 億美元，年增 1,643 億美元(+53.0%)，占總出口比重達 7 成 4。

## (三)機械出口年增 7.0%，為近 4 年最佳表現

雖近年來續受日圓大幅貶值，以及中國大陸產品低價競爭拖累，我國工具機出口連 3 年衰退，惟在機器、工廠或實驗室設備外銷劇增 12.9 億美元(+3.2 倍)，生產半導體等機械增 5.1 億美元(+10.2%)之貢獻下，114

年整體機械出口 258 億美元，轉增 17 億美元(+7.0%)。若就主要出口市場觀察，以銷往美國及日本分別增 9.2 億美元(+15.7%)、3.1 億美元(+17.7%)較多，對歐洲、東協各增 8.4%及 6.5%，中國大陸與香港小增 1.4%。

#### **(四)國際原油與石化產品供給過剩，我礦塑化產品出口續減 3.2%**

受到國際原油供應過剩，中國大陸經濟復甦不如預期，以及地緣政治緊張等因素交互影響下，去年原油價格震盪走低，以 OPEC 原油每桶均價觀察，由 113 年底之 74.59 美元跌至 114 年底之 61.01 美元，跌幅 22.3%。受油價持續下滑及買氣低迷衝擊，我國礦產品(主要為石油煉製品)114 年出口 139 億美元，在基期偏低下續減 0.2%，化學品、塑橡膠及其製品因國際同業持續擴產及庫存過高壓力，出口分別年減 0.2%及 8.1%，已連續 3 至 4 年衰退，若將礦、塑、化產品合併觀察，114 年出口 502 億美元，年減 3.2%。

#### **(五)陸廠鋼材外銷量持續擴張衝擊下，我基本金屬及其製品出口再降 2.0%**

中國大陸對其鋼鐵生產過剩情勢，雖有加大政策救市力道，惟受國內房地產市場疲軟影響，鋼價低檔震盪，加以庫存過高，鋼廠續向海外市場傾銷，嚴重衝擊周邊國家鋼鐵供需秩序。114 年我國基本金屬及其製品出口 279 億美元，年減 5.8 億美元(-2.0%)，其中鋼鐵及其製品減 14.5 億美元(-9.0%)，銅及其製品增 9.8 億美元(+21.5%)。

紡織產業下游成衣廠雖需求轉強，訂單能見度提升，惟上中游廠商仍囿於中國大陸產能過剩與全球削價競爭影響，陸續有業者關廠或減產，114 年我國紡織品出口 62 億美元，減少 5.1 億美元(-7.5%)。

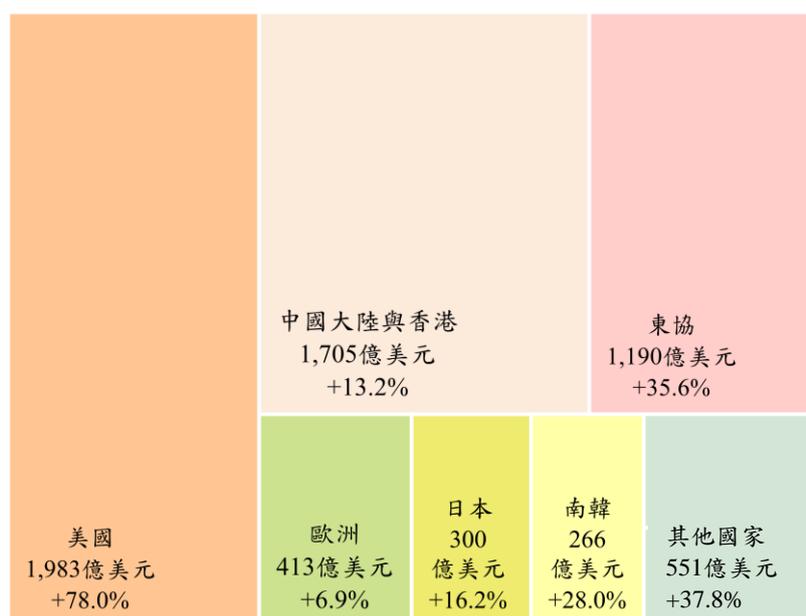
### **四、對主要國家/地區出口**

#### **(一)對美國、東協、南韓出口值同創新高，以對美逼近 2 千億美元最顯**

隨人工智慧熱潮帶動資通與視聽產品輸出暢旺，114 年對美國出口 1,983 億美元，較上年增 78.0%，雙雙刷新歷史紀錄，連續 9 年正成長；受惠於電子零組件出貨動能回升，對中國大陸與香港出口 1,705 億美元，

轉為上升 13.2%，終止連 3 年跌勢；對東協出口 1,190 億美元，首度突破千億美元大關，年增 35.6%，以資通與視聽產品、電子零組件為兩大主力；對歐洲出口 413 億美元，年增 6.9%，主要係資通與視聽產品、電子零組件、機械等出貨上升；對日本出口 300 億美元，年增 16.2%，為近 4 年來最大增幅，以電子零組件、資通與視聽產品、機械為主要成長動能；對南韓以電子零組件表現一枝獨秀，改寫新高，推升出口值至 266 億美元，年增 28.0%。

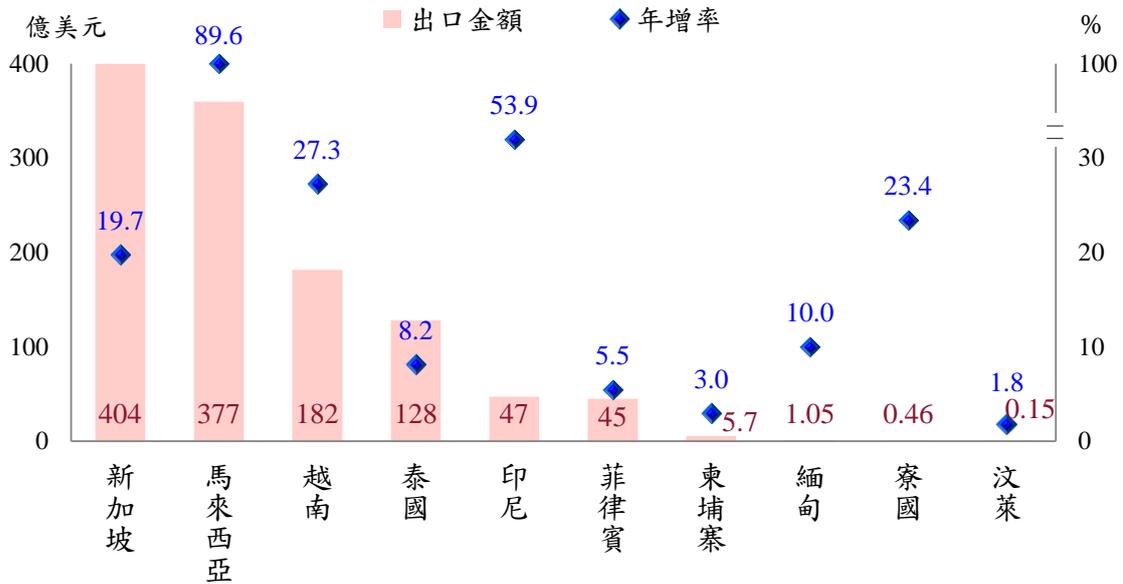
圖 4 114 年對主要市場出口金額及年增率



## (二)對東協 10 國出口全面上揚，對星、馬、越、泰、寮改寫新紀錄

114 年我對東協 10 國出口全面上揚，受惠於供應鏈移轉效應及 AI 商機驅動，對新加坡(資通與視聽產品)、馬來西亞(資通與視聽產品、電子零組件)、越南(電子零組件、資通與視聽產品)、泰國(電子零組件)出口值皆攀升高峰，增幅分別為 19.7%、89.6%、27.3%、8.2%；對寮國出口亦創新高，年增 23.4%，主因化學品(金屬導電漿)、紡織品輸出擴增；對印尼及菲律賓分別因資通與視聽產品、電子零組件外銷暢旺，各年增 53.9%、5.5%；對柬埔寨(電機產品)、緬甸(機械、紡織品)、汶萊(資通與視聽產品)出口增幅介於 1.8%~10.0%。

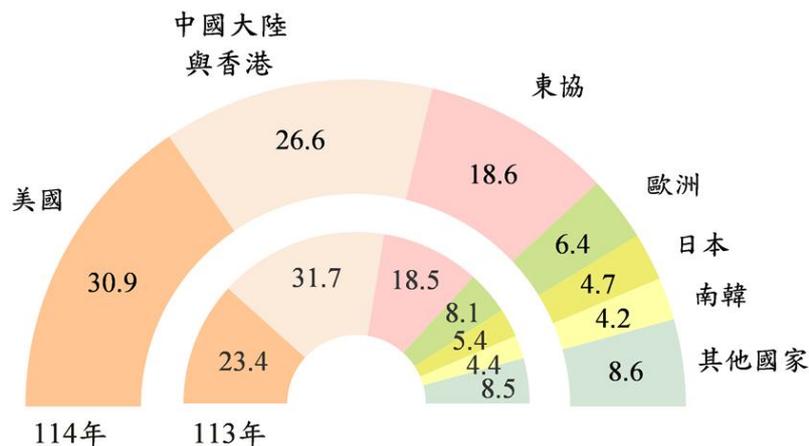
圖 5 114 年對東協 10 國出口概況



### (三)美國重返我最大出口市場

114 年對美國出口占比較上年大幅提高 7.5 個百分點至 30.9%，為近 35 年最高水準，對中國大陸與香港出口比重 26.6%，降至近 25 年新低，較歷史高點(109 年 43.9%)重挫 17.3 個百分點；影響所及，對美出口占比近 26 年來首度超越陸港，重返我最大出口市場；對東協占比 18.6%，雖僅較上年略增 0.1 個百分點，仍為近 11 年最佳表現，其中對馬來西亞增 1.7 個百分點最為亮眼；對歐洲出口占 6.4%、對日本占 4.7%，同步跌至歷史低點，較上年分別滑落 1.7、0.7 個百分點；南韓占比 4.2%，年減 0.2 個百分點。

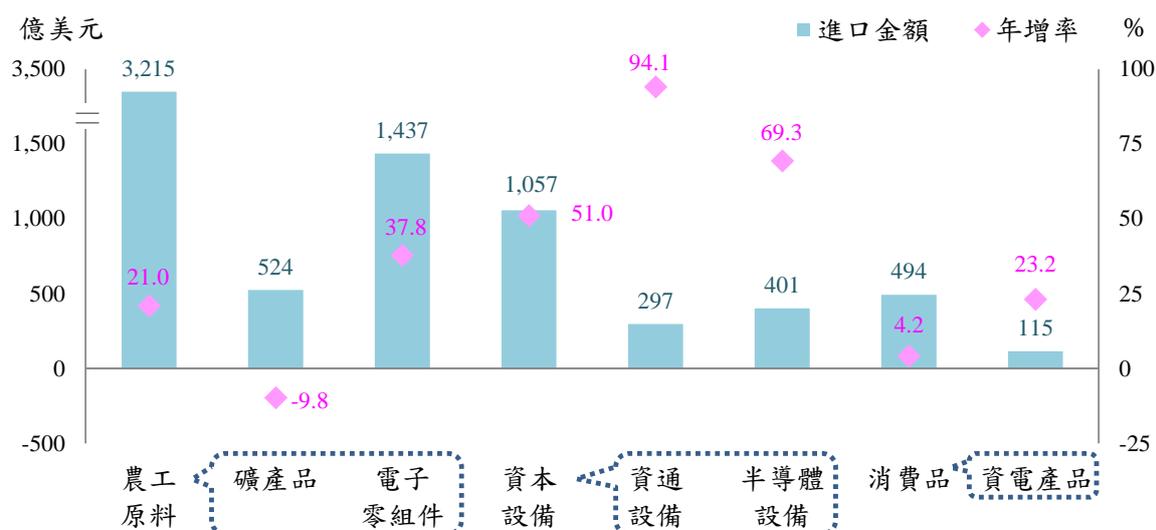
圖 6 近年對主要市場出口占比(%)



## 五、進口主要貨品及來源地區

隨與人工智慧商機息息相關的高頻寬記憶體(HBM)等電子零組件輸入增加，114年農工原料進口年增2成1；資本設備因半導體及資通設備購置劇增，年增5成1；消費品因資電等產品買氣提升，年增4.2%；三大用途別之進口值均創歷年新高。

圖7 114年進口貨品金額及年增率



### (一)隨電子零組件進口大幅成長37.8%，推升農工原料年增21.0%

受惠於人工智慧產業鏈國際分工，以及出口衍生需求增加，114年農工原料進口3,215億美元，年增557億美元(+21.0%)，其中電子零組件進口1,437億美元，增394億美元(+37.8%)，項下以記憶體增225億美元(+56.0%)最多，電腦之零附件增178億美元(+2.8倍)，礦產品減9.8%、基本金屬減3.0%、塑化原料減0.9%。

### (二)半導體及資通設備進口各增7成及9成，帶動資本設備大增5成

由於AI帶動半導體設備投資及資通設備購置需求，114年資本設備進口1,057億美元，年增357億美元(+51.0%)，其中半導體設備增164億美元(+69.3%)，資通設備增144億美元(+94.1%)，電機設備增19億美元(+36.7%)，交通運輸設備則微減0.6%。

### (三)消費品進口年增 4.2%，資電、食品進口均創新高

消費品 114 年進口 494 億美元，年增 19.7 億美元(+4.2%)，其中資電產品項下之 SSD 等儲存裝置增 15.6 億美元(+73.1%)、食品增 6.1 億美元(+5.7%)、藥粧用品增 3.5 億美元(+4.3%)、手機增 2.0 億美元(+6.2%)，小客車則因臺美汽車關稅未定，消費者持續觀望，減 14.1 億美元(-17.3%)。

### (四)自陸港、南韓、東協、美國進口齊攀高峰

114 年自中國大陸與香港進口 931 億美元，年增 15.5%，以電子零組件、電機產品、資通與視聽產品、機械等增加較為顯著；自南韓進口 637 億美元，年增 45.7%，主因電子零組件進口激增；自東協進口 626 億美元，年增 27.0%，其中自馬來西亞(精密儀器、機械、資通與視聽產品)、越南(資通與視聽產品)、新加坡(機械、精密儀器)、泰國(電子零組件)輸入擴增，進口值均創新高，分別年增 27.7%、80.6%、34.4%、5.7%；自日本進口 548 億美元，增 18.0%，以電子零組件、機械進口增加較多；自歐洲進口 505 億美元，增 9.9%，主因自荷蘭進口機械(半導體用之掃瞄對準機)增加；自美國進口 482 億美元，年增 3.2%，主要增加貨品為電子零組件、機械。上述主要進口市場占比僅自南韓、東協各增 2.1、0.4 個百分點，餘皆呈下降。

表 2 114 年自主要市場進口概況

單位：億美元；%

	中國大陸 與香港	南韓	東協	日本	歐洲	美國
金額	931	637	626	548	505	482
上半年	432	280	282	264	248	237
下半年	499	357	343	284	257	245
年增率	15.5	45.7	27.0	18.0	9.9	3.2
上半年	13.7	56.3	18.6	19.0	12.7	-10.0
下半年	17.0	38.3	34.9	17.1	7.4	20.3
占比	19.3	13.2	12.9	11.3	10.4	10.0
增減百分點	-1.2	+2.1	+0.4	-0.5	-1.2	-1.8

## 六、貿易餘額

出、進口互抵後，114年出超金額達1,571億美元，創歷年新高，較113年大幅增加766億美元，挹注出超之貨品與國家均具高度集中性。在主要貨品方面，以資通與視聽產品出超1,825億美元居各貨類之首，年增835億美元，規模值不僅改寫歷史紀錄，亦高於總出超，反映全球算力需求激增、各國積極布建AI基礎設施，而我國在相關製造領域具備完整產業鏈與技術優勢，得以即時回應國際市場需求；電子零組件出超792億美元居次，年增62億美元。礦產品為最大入超貨品，114年為385億美元，年減57億美元；機械、光學及精密儀器則因國內廠商持續擴充半導體先進製程與高階封裝產能，入超金額分別增加124億、50億美元。

按國家/地區別觀察，114年我對美國出超以1,501億美元刷新最高紀錄，較113年增加854億美元，並取代中國大陸與香港，成為我國最大出超來源；對陸港出超774億美元，年增74億美元；對東協出超564億美元，亦創歷年新高，年增179億美元，以對馬來西亞出超增加138億美元較多。至於入超國家中，隨臺、韓在AI產業鏈之分工運作持續深化下，114年我對南韓入超371億美元，再創新高，年增141億美元；對日本入超248億美元，年增42億美元。

表3 主要貨品與國家/地區別出入超

單位：億美元

	總計	主要貨品別						
		資通與 視聽產品	電子 零組件	塑橡膠 及其製品	礦產品	機械	化學品	光學及 精密儀器
113年	806	990	729	102	-441	-118	-112	-52
114年	1,571	1,825	792	81	-385	-242	-107	-103
較上年增減	+766	+835	+62	-22	+57	-124	+5	-50
	國家/地區別							
	美國	中國大陸 與香港	東協	新加坡	馬來西亞	南韓	日本	歐洲
113年	647	699	385	240	53	-229	-206	-73
114年	1,501	774	564	274	190	-371	-248	-92
較上年增減	+854	+74	+179	+33	+138	-141	-42	-19

說明：入超項下之增減比較，「-」表示入超金額增加，「+」表示入超金額減少。

## 七、結語

在人工智慧引領之創新科技應用需求強勢帶動下，114 年我國出、進口總值同創佳績，分別較 113 年成長 34.9%、22.6%。主要貨品中，以資通與視聽產品、電子零組件扮演出口兩大支柱，規模值雙雙創下歷年新高，合占總出口比重達 7 成 4，兩者併計年增 53.0%，其餘貨類平均僅增加 0.9%，包含塑橡膠、基本金屬製品在內之傳產貨類仍普遍面臨國際間產能過剩、低價搶單壓力，出口持續萎縮。對主要市場出口同步上揚，其中對美國、東協出口分別增 78.0%、35.6%，皆優於總平均，規模值亦改寫新高紀錄；外銷版圖受全球供應鏈重組、去中化趨勢等因素影響，美國所占比重上升至 30.9%，創近 35 年高點，且超越中國大陸與香港，成為我國最大出口國，係民國 89 年來首見。

展望未來，隨雲端服務供應商持續加碼 AI 資本支出，各國積極推動主權 AI，皆可望支撐相關硬體需求，加上國內半導體先進製程與高階封裝產能陸續開出，以及本年 1 月中旬臺美關稅談判達成共識，均有助於推升我國出口成長動能；惟仍須密切關注美國貿易政策、地緣政治情勢等不確定因素，以及人工智慧投資落實之進程。